

株式会社レゾナック・ホールディングス  
〒105-7325 東京都港区東新橋 1-9-1  
2026年4月21日

## 日米企業による次世代半導体パッケージ開発・コンソーシアム「US-JOINT」本格稼働

— シリコンバレーでの式典に日米官民関係者が集結、開発スピード加速に期待 —

株式会社レゾナック（代表取締役社長 CEO：高橋秀仁、以下、当社）は、次世代半導体パッケージ分野における新たな技術開発モデルの構築を目指し、当社が主体となり、日米の材料・装置メーカーなど12社が参画するコンソーシアム「US-JOINT」が本格稼働を開始したことをお知らせします。始動にあたり、4月20日（現地時間）、米国・シリコンバレーの現地拠点にて、日米の政府関係者・参画企業などが出席した、オープニングセレモニーを開催しました。なお、US-JOINTは米国初の、先端半導体パッケージに特化したコンソーシアムとなります。



「US-JOINTは、日米の参画企業12社が、ハイパースケーラーの拠点であるシリコンバレーで開発を行うことにより、コンセプト検証の期間を約6か月から、最短で1か月程度にまで短縮することを目指します。日米の半導体関連企業が「共創」することで、世界の半導体のイノベーションを加速させます。」  
（株式会社レゾナック 代表取締役社長 CEO 高橋秀仁）

「US-JOINTのような共創の取り組みは、まさに業界がこれまで必要としてきたものだと感じています。シリコンバレーでUS-JOINTのR&Dセンターが本格稼働することを、大変楽しみにしています。この取り組みによって半導体イノベーションが加速し、現在の延長線上にとどまらない、まったく新しいブレイクスルーが生まれることを期待しています。」  
（Broadcom Inc. Vice President and Head of Global IC Operations Dilip Vijay（ディリップ・ヴィジャイ）氏）

「US-JOINTがシリコンバレーを拠点に本格稼働することで、対面での技術対話が促進され、フィードバックの迅速化や認識の明確化を通じて、より効率的な共同開発が進むことを期待しています。本イニシアチブを通じて生まれるイノベーションや、エコシステム全体における協業のさらなる強化に大いに期待しています。」  
（Advanced Micro Devices, Inc. Vice President of Heterogeneous Integration Technologies Raja Swaminathan（ラージャ・スワミナサン）氏）

「生成AIの急速な拡大とそれに伴う計算需要の高度化により、半導体は、先進的なパッケージング技術が求められています。このUS-JOINTが、生成AI向けコンピューティングにおける先進パッケージングおよびチップレット技術のイノベーションの出発点になると強く確信しています。本日の取り組みに尽力されたすべての皆さまに深く感謝するとともに、この一歩が、米国と日本、そして世界にとって大きな成果となることを心より願っています。」  
（経済産業省大臣官房審議官（情報政策担当） 商務情報政策局半導体戦略統括調整官 西川 和見氏）

生成 AI や自動運転などの成長分野では、半導体の性能向上に伴い、後工程における先端半導体パッケージ技術の重要性が一層高まっています。一方で、新しいパッケージコンセプトが次々に生まれる中、それらを迅速かつ実践的に検証できる環境が限られていることが、技術開発のボトルネックとなっていました。

US-JOINT は、シリコンバレーの研究開発拠点を活用し、先端半導体の主要ユーザーである顧客とともに半導体パッケージの最新コンセプトの検証を行います。市場ニーズをリアルタイムで捉え、日米トップメーカーの材料・装置分野の技術力と、米国の半導体ユーザーや新しいアイデアが集積する環境を掛け合わせることで、材料、評価・実装技術の研究開発を加速させ、新技術の早期実用化・事業化につなげていきます。

### ■US-JOINT における当社の役割

当社は、半導体製造プロセスの各工程に不可欠な、複数の半導体材料において世界トップクラスのシェアを有しています。材料自体の高い特性に加え、プロセス全体を俯瞰した技術提案力と課題解決力が、当社の大きな強みです。また、JOINT2、JOINT3 をはじめとする複数のコンソーシアムにおいて、材料・装置メーカー各社と共創を推進してきた実績とノウハウを有しています。こうした経験に基づく運営力と業界内での信頼が、材料メーカーの立場から業界全体をつなぐ役割を可能にしています。

US-JOINT において当社は、これらの技術基盤と知見を生かし、コンソーシアム全体を俯瞰しながら共創を推進する中核的な役割を担います。半導体プロセス全体を見渡せる材料メーカーとして、参画企業各社の技術やアイデアを集結し、市場ニーズを踏まえたコンセプト検証や共創の加速に貢献していきます。

### ■US-JOINT 概要

名称	US-JOINT (JOINT : Jisso Open Innovation Network of Tops)
目的	米国における次世代半導体パッケージの評価プラットフォーム創成と実装技術の開発
参画企業 アルファベット順	12 社 (2026 年 4 月 20 日時点) Azimuth Industrial、KLA Corporation、Kulicke and Soffa Industries、メック株式会社、Moses Lake Industries、ナミックス株式会社、東京応化工業株式会社、TOPPAN 株式会社、TOWA 株式会社、株式会社アルバック、3M Company、株式会社レゾナック
所在地	米国カリフォルニア州 ユニオンシティ
稼働開始	2026 年 4 月 (本格稼働)
主な設備・環境	先端半導体パッケージングプロセス (パターンング、ボンディング、モールド、めっき等)、評価・解析装置、クリーンルーム (クラス 100, 1,000)
拠点の役割	次世代半導体パッケージのコンセプト検証を行う研究開発拠点
想定利用者	ファブレス企業、半導体メーカー、参画企業の技術者



【Resonac（レゾナック）について】

レゾナックは、2023年1月に昭和電工と旧日立化成が統合して発足した機能性化学メーカーです。

2025年度の半導体・電子材料の売上高は、約5,000億円に上り、特に半導体の「後工程」材料では世界トップクラスの企業です。2社統合により、材料の機能設計はもちろん、自社内で原料にまでさかのぼって開発を進めています。社名の「Resonac」は、英語の「RESONATE：共鳴する・響き渡る」と、Chemistryの「C」の組み合わせです。今後さらに共創プラットフォームを生かし、国内外の半導体メーカー、材料・装置メーカーとともに技術革新を加速させていきます。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

株式会社レゾナック・ホールディングス <https://www.resonac.com/jp/>